

製品納期に関するお知らせ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、電子部品・電子機器業界では、AI・データセンター向けの設備投資が急速に拡大しており、それに伴い、半導体・電子部品等の需要も大幅に増加しております。これに加え、中東情勢等の地政学的リスクによる物流・サプライチェーンへの影響や、半導体関連・一部産業への需要集中などにより、特定の部品・分野で生産能力が逼迫し、供給が不安定となる状況が続いております。

この影響により、弊社製品に使用する基板等の一部部材につきましても、材料の入手が困難となり、基板メーカーより納期未定との案内を受けるケースが発生しております。
また、弊社におきましても、今後の供給状況を見越したご注文が本年4月頃より増加しており、受注が集中していることから、従来の納期での製品供給が難しい状況となっております。

現時点で、すべての製品・部品が長納期化しているわけではございませんが、今後の需給状況や部材の調達状況によっては、通常より納期を要する場合がございます。
つきましては、すでにご注文いただいている製品および今後ご注文いただく製品につきまして、今後の需給状況や部材の調達状況により、従来の納期から変更となる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、製品ごとの納期につきましては、個別にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

お客様にはご不便、ご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、安定した製品供給に向けて引き続き最大限努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。